

「第6回フジコミーティング」研究進捗報告タイトル

日時：平成29年3月23日（木）13:00～17:00

場所：三次元半導体研究センター隣接 「社会システム実証センター」3Fセミナー室

【FUJIKO Format】

「今期の活動結果と来期の活動計画」 株式会社図研 松澤浩彦氏

【福岡大学半導体実装研究所】

「今年度の実施内容の報告」 加藤義尚教授

「SLBIC法を用いた微細TSVの評価」 崔雲助教

「部品内蔵基板の開発及びChip実装時の応力評価」 堀内整研究員

「3次元半導体研究センターの高周波伝送特性評価技術（差動ストリプライン／微細パターンCPW）」
韓榮建研究員

【三次元半導体研究センター】

「FUJIKOミーティング(2016年度報告)センター技術進捗報告」 野北寛太副センター長

「3次元半導体研究センターにおけるウエハー薄研削の取り組み」 佐々木匠研究員

「高アスペクト微細TSVのプロセス技術」 八木公輔研究員

「微細配線TEG：SI15の設計と適用事例」 光富久光研究員

「超微細配線形成のためのスパッタ膜の密着性評価」 末吉晴樹研究員

「配線表面状態と信号品質の評価」 相島博之研究員

「新プロセスのための2016年度 内部装置開発」 林繁宏研究員

「TGV開発および高周波特性評価用の特殊構造基板開発」 定別当裕康研究員

「表面処理技術の活用における三次元半導体研究センターの取り組み」 古橋啓太研究員